

新素材シリーズ アルコナノ[®]銀ペースト

高耐熱性+高信頼性

ALCONANO Ag

SiC 対応

ダイボンド接合 ナノマテリアル

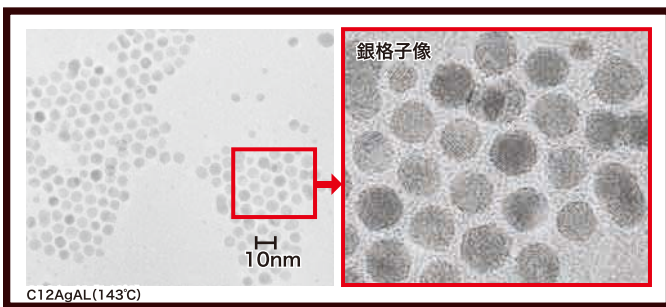
新製品

アルコナノ[®]銀ペースト

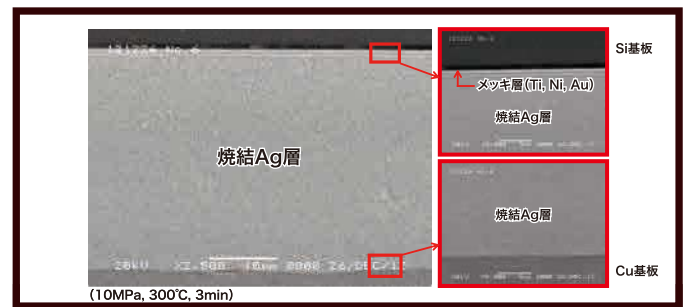
- 低温焼成可能
- 高耐熱性
- 高熱伝導性
- 高接合強度
- 高信頼性

無加圧下では200~350°Cの低温焼成が可能であり、加圧下では短時間の焼成による良好な接合状態を得ることができます。Pb高温はんだの代用はもとより、SiC素子等の次世代パワーモジュールの接合に最適な高い電気伝導性と熱伝導性を有するナノ銀ペーストです。

アルコナノ[®]銀粒子HRTEM写真



接合断面SEM写真



用途

- パワーモジュール向け
- LED
- 太陽電池 等

アルコナノ[®]銀ペースト



上記データ、写真は特定条件下によるものです。
Copyright © Nihon Superior Co., Ltd. All rights reserved.



▶ 製品のお問い合わせは弊社営業部まで。 www.nihonsuperior.co.jp

株式会社 日本スぺリア社 TEL 大阪 06(6380)1121 / 担当窓口 06(6380)3776

製造元：株式会社応用ナノ粒子研究所 大阪市住吉区杉本 3-3-138 大阪市立大学インキュベータ